

# 半导体

证券研究报告

2021年09月13日

## 看多扩产周期，大陆军备式扩产利好本土设备材料

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

本周行情概览:

本周半导体行情显著跑赢主要指数。本周申万半导体行业指数上涨 5.78%，同期创业板指数上涨 4.19%，上证综指上涨 3.39%，深证综指上涨 4.17%，中小板指上涨 3.77%，万得全 A 上涨 3.58%。半导体行业指数显著跑赢主要指数。

半导体设备涨幅居前，一如我们此前的判断。半导体细分板块中，半导体设备板块本周上涨 6.6%，半导体材料本周上涨 4.7%，半导体制造板块本周上涨 4.1%，封测板块本周上涨 3.5%，IC 设计板块本周上涨 3.4%，分立器件板块本周上涨 2.1%，其他板块本周上涨 1.2%。

### 看多扩产周期，大陆军备式扩产利好本土设备材料

中国大陆二季度半导体设备订单金额全球居首。SEMI 于 9 月 7 日发布 2Q21 全球半导体制造设备订单金额统计，二季度全球半导体设备订单达到 248.7 亿美元，分地区来看，中国大陆 82.2 亿美元，金额全球最高，YoY +79%；其次为韩国 66.2 亿美元，YoY +48%；中国台湾 50.4 亿美元，YoY +44%；日本 17.7 亿美元，YoY +2%；北美 16.8 亿美元，YoY +2%；其他地区 8.4 亿美元，YoY +129%；欧洲 7.1 亿美元，YoY +54%。

看多扩产周期，我们判断大陆已进入军备式扩产期，本土设备材料或将持续受益。我们判断在中美贸易冲突、全球半导体景气周期上行、5G+AI 催生新需求等多重因素影响下，中国大陆已进入军备式扩产期，扩产速度和国产化推进情况均有望超预期，为本土半导体设备材料板块带来新动能。

下半年代工厂涨价延续，以台积电为首的多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价，行业高景气持续。2020 年 Q3 以来，半导体公司纷纷上调产品价格。这波涨价热潮一直延续至今，台积电 8 月 24 日先行向联发科、瑞昱与联咏等多家客户告知 16 奈米以上制程将全面大涨 20%，12 月新单将正式生效，也就是目前所谈定的 11 月订单全部收完后，12 月晶圆产出 (wafer out) 正式起涨。此外，联电、中芯、GlobalFoundries(GF)、世界先进、力积电与华虹等多家晶圆代工厂宣布涨价。

扩产周期向上，持续看好国产半导体设备材料的机会。半导体扩产周期正在上行：全球晶圆代工资本开支占收入比重达 53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030 大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，我们判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。

建议关注:

FPGA: 紫光国微/复旦微电

半导体设备材料: 北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/华峰测控/长川科技/有研新材/江化微/ASM pacific

半导体制造封测: 中芯国际/华虹半导体/闻泰科技/三安光电/华润微/士兰微/长电科技/通富微电

半导体设计: 晶晨股份/中颖电子/全志科技/瑞芯微/恒玄科技/兆易创新/富瀚微/圣邦股份/思瑞浦/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/斯达半导/新洁能/澜起科技/汇顶科技/上海贝岭

风险提示: 疫情继续恶化; 贸易战影响; 需求不及预期

作者

潘暕

分析师

SAC 执业证书编号: S1110517070005  
panjian@tfzq.com

骆奕扬

分析师

SAC 执业证书编号: S1110521050001  
luoyiyang@tfzq.com

程如莹

联系人

chengruiying@tfzq.com

行业走势图



资料来源: 贝格数据

相关报告

- 《半导体-行业深度研究:半年报总结:周期上行,加码成长》2021-09-07
- 《半导体-行业研究周报:IC设计企业基本面有望超预期,价值投资机会浮现》2021-09-05
- 《半导体-行业研究周报:高景气下扩产行情持续,多家公司H1业绩亮眼》2021-08-29



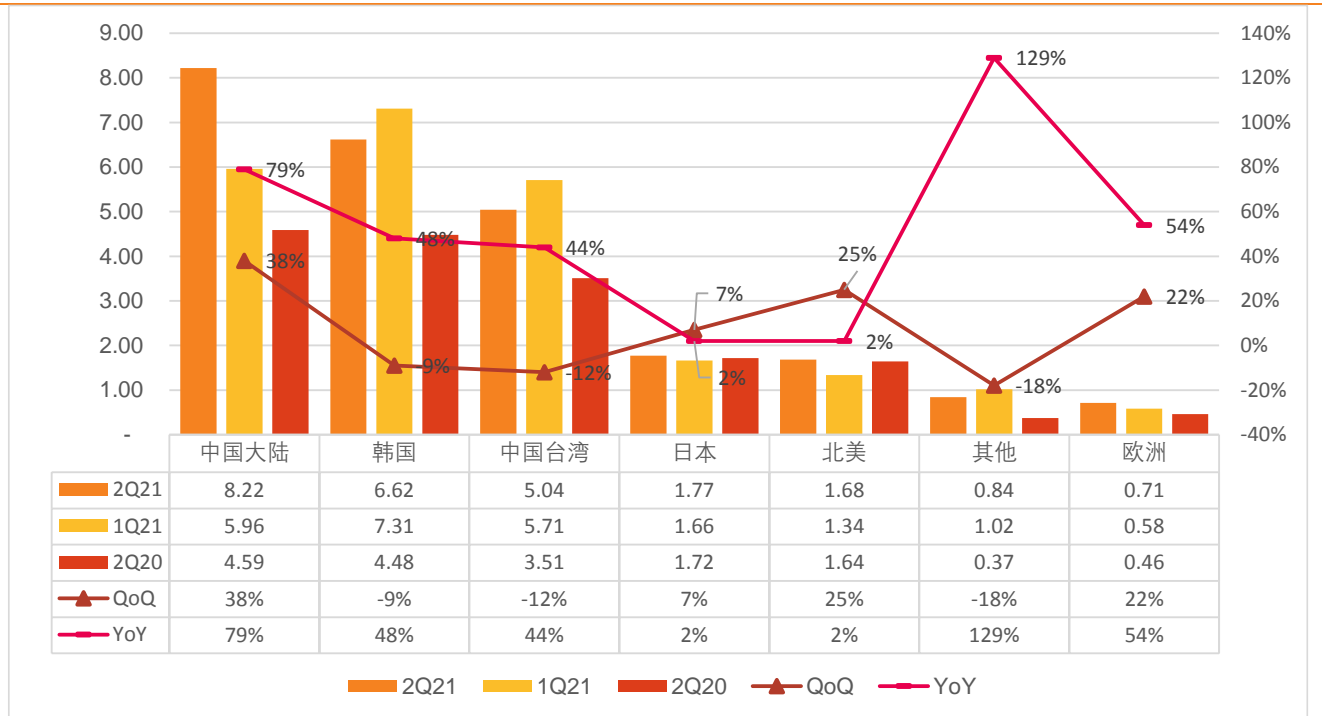
## 内容目录

1. 看多扩产周期，大陆军备式扩产利好本土设备材料 .....	3
2. 周观点: .....	4
3. 本周半导体行情回顾.....	5
4. 本周重点公司公告 .....	6
5. 本周半导体新闻 .....	8
5.1. IC 设计.....	8
5.2. 设备/材料.....	9
5.3. 代工/封测.....	9
5.4. EDA/IP/其他 .....	10
6. 风险提示: .....	11

## 1. 看多扩产周期，大陆军备式扩产利好本土设备材料

中国大陆二季度半导体设备订单金额全球居首。SEMI 于 9 月 7 日发布 2Q21 全球半导体制造设备订单金额统计，二季度全球半导体设备订单达到 248.7 亿美元，分地区来看，中国大陆 82.2 亿美元，金额全球最高，YoY +79%；其次为韩国 66.2 亿美元，YoY+48%；中国台湾 50.4 亿美元，YoY+44%；日本 17.7 亿美元，YoY +2%；北美 16.8 亿美元，YoY +2%；其他地区 8.4 亿美元，YoY +129%；欧洲 7.1 亿美元，YoY +54%。

图 1：全球半导体制造设备订单金额统计（十亿美元）



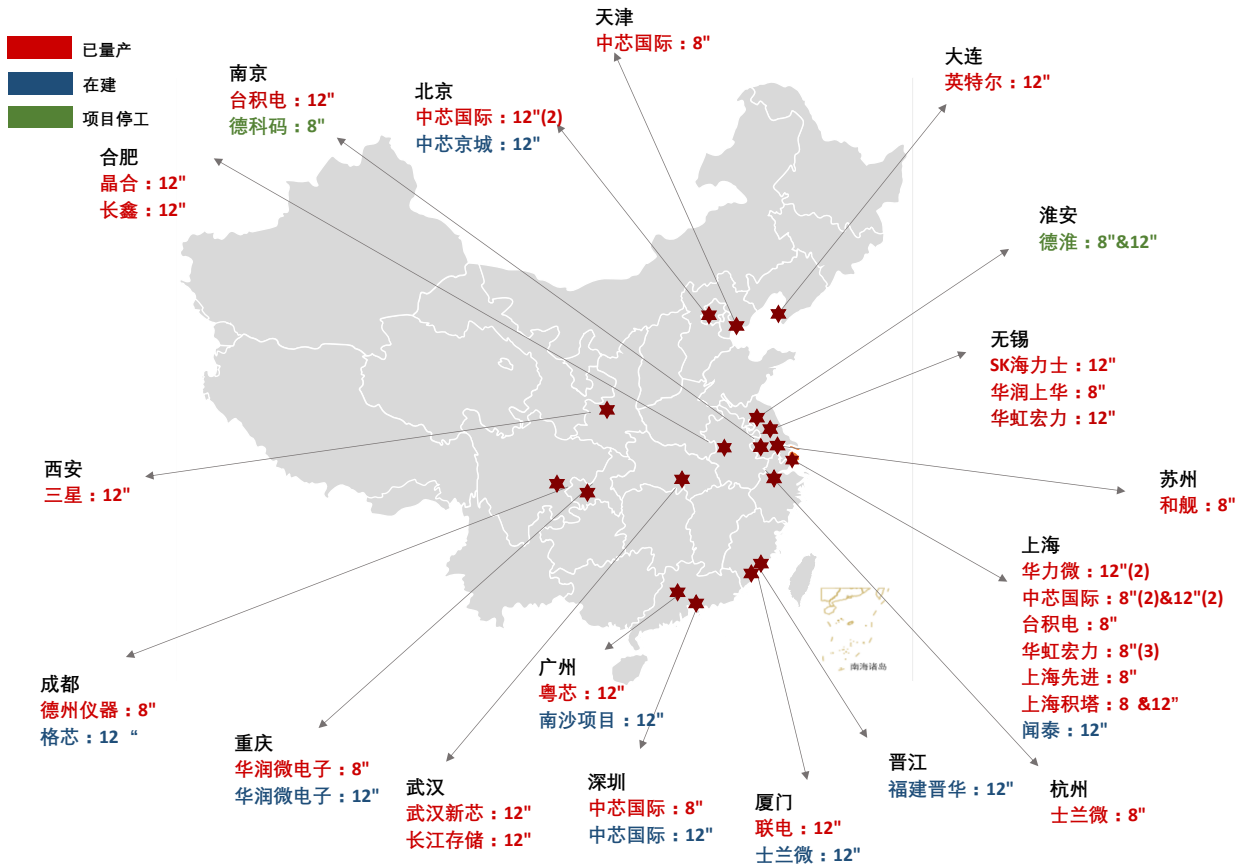
资料来源：SEMI，天风证券研究所

**看多扩产周期，我们判断大陆已进入军备式扩产期，本土设备材料或将持续受益。**我们判断在中美贸易冲突、全球半导体景气周期上行、5G+AI 催生新需求等多重因素影响下，中国大陆已进入军备式扩产期，扩产速度和国产化推进情况均有望超预期，为本土半导体设备材料板块带来新动能。

**下半年代工厂涨价延续，以台积电为首的多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价，行业高景气持续。**2020 年 Q3 以来，半导体公司纷纷上调产品价格。这波涨价热潮一直延续至今，台积电 8 月 24 日先行向联发科、瑞昱与联咏等多家客户告知 16 奈米以上制程将全面大涨 20%，12 月新单将正式生效，也就是目前所谈定的 11 月订单全部收完后，12 月晶圆产出(wafer out)正式起涨。此外，联电、中芯、GlobalFoundries(GF)、世界先进、力积电与华虹等多家晶圆代工厂宣布涨价。

**扩产周期向上，持续看好国产半导体设备材料的机会。**半导体扩产周期正在上行：全球晶圆代工资本开支占收入比重达 53%，连续三年提高。半导体产能有望持续向大陆转移，2020-2030 大陆半导体资本开支复合增速有望高于全球。贸易摩擦背景下，中国大陆半导体设备材料国产化率未来有望持续提高。综合制造板块的加速扩张，叠加国产化率提高，我们判断半导体设备材料板块有预期上修空间，持续看好国产半导体设备材料的机会。

图 2：大陆半导体制造产能分布



资料来源：中芯国际官网，华虹半导体官网，北京经济技术开发区官网，中国电子报，电子工程专辑，华润微官网，中国半导体行业协会，中证网，华力微官网，第一财经，上海先进官网，闻泰科技官网，士兰微官网，央广网，福布斯，中国科技网，集微网，澎湃新闻，中国经营网，天风证券研究所

## 2. 周观点：

**周期上行，加码成长。**周期持续上行，涨价+扩产+产品结构提升，让半导体板块二季度迎来戴维斯双击，板块涨幅达 51%，大幅跑赢主要指数。站在第三季度的时点，随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产约束在年内难以大规模释放，我们预计供不应求的格局至少持续到年底，高景气度的持续性提供了持续超预期的动力。需求提升和国产替代带来的“量”的增长值得被更加关注，我们判断扩产和国产化的趋势将超出预期，持续看好国产半导体设备材料板块；我们判断车用半导体、IoT、特种 IC 正在量价齐升的初期，手机、PC、电视等结构性升级带来的半导体价值量提升也将助力相关国产设计厂商持续高速增长；我们判断国产半导体制造板块已进入战略扩产期，高景气度背景下，下半年有望量价齐升。

**半导体制造：扩产涨价，量价齐升。**涨价+UTR 提升+产品结构优化，二季度半导体制造板块景气度进一步提升。二季度制造板块营收同比增 45%，归母净利润同比增 261%。我们判断本土制造已进入战略扩产期，下半年有望迎来涨价行情。建议关注：中芯国际/华虹半导体

**IC 设计：从“价提”到“量增”。**“涨价”仍是关键词，二季度板块业绩大增，验证景气度。二季度 IC 设计板块营收同比提升 60%，归母净利率环比提升至 22%。二季度半导体供需格局持续紧俏，部分产品持续涨价，高景气度带动了板块业绩提升。下半年随着晶圆代工的涨价，预计部分 IC 设计厂商有能力向下游转嫁，下半年缺货涨价会持续。从“价提”到“量增”，重视新产品、新市场带来的新机遇。建议关注：韦尔股份/紫光国微/卓胜微/兆易创新/圣邦股份/澜起科技/北京君正/瑞芯微/思瑞浦/汇顶科技/晶晨股份/恒玄科技/富瀚微/上海贝岭/晶丰明源/全志科技。

**半导体设备材料：持续受益扩产+国产化。**扩产周期向上，二季度营收高增长。二季度半导体行业产能持续紧缺，多处工厂在执行扩产计划，半导体设备材料板块营收端实现高增长，设备板块二季度营收增长 52%，材料板块营收增长 61%。芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料成长潜力大。建议关注：北方华创/雅克科技/精测电子/华峰测控/长川科技/中微公司/芯源微/有研新材/上海新阳/华特气体/至纯科技/盛美半导体

### 3. 本周半导体行情回顾

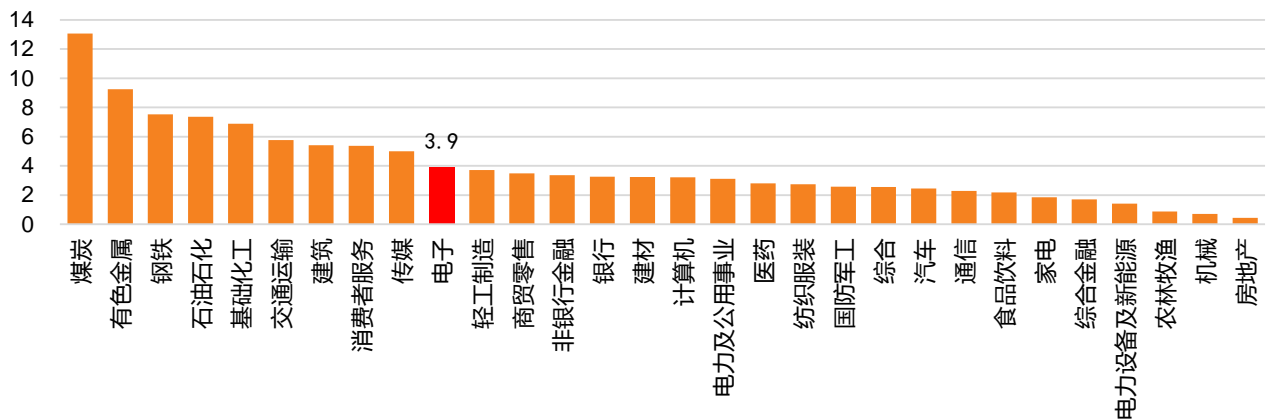
**本周半导体行情显著跑赢主要指数。**本周申万半导体行业指数上涨 5.78%，同期创业板指数上涨 4.19%，上证综指上涨 3.39%，深证综指上涨 4.17%，中小板指上涨 3.77%，万得全 A 上涨 3.58%。半导体行业指数显著跑赢主要指数。

表 1：本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	4.19	1.60
上证综合指数	3.39	2.39
深证综合指数	4.17	1.61
中小板指数	3.77	2.01
万得全 A	3.58	2.20
半导体 (申万)	5.78	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

图 3：本周 A 股各行业行情对比 (%)

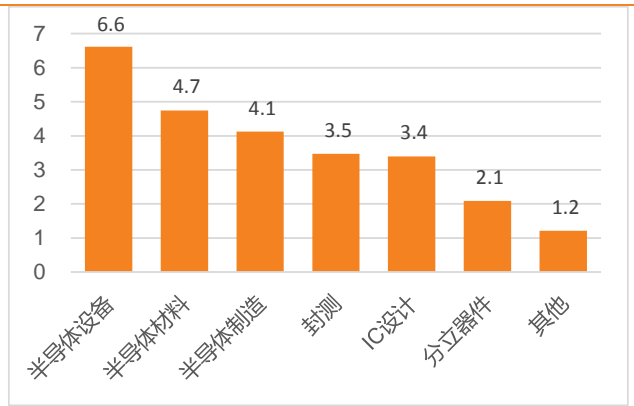


资料来源：Wind，天风证券研究所

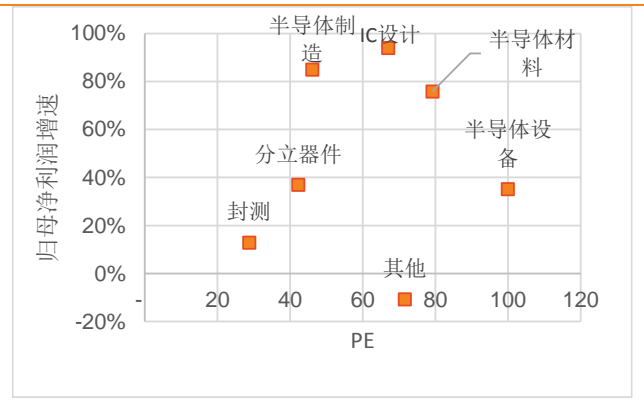
**半导体设备涨幅居前，一如我们此前的判断。**半导体细分板块中，半导体设备板块本周上涨 6.6%，半导体材料本周上涨 4.7%，半导体制造板块本周上涨 4.1%，封测板块本周上涨 3.5%，IC 设计板块本周上涨 3.4%，分立器件板块本周上涨 2.1%，其他板块本周上涨 1.2%。**天风电子团队近期多次强调半导体设备材料板块的机会**，5 月 24 日报告《后摩尔时代，国产半导体设备材料有预期上修空间》中明确提出“当前时间节点，短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕，二/三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。”6 月 16 日报告《持续看好国产半导体设备材料》和 7 月 19 日报告《台积电上修半导体预期，持续看好国产设备材料》重申观点，**目前我们持续看好设备材料板块。**

图 4：本周子板块涨跌幅 (%)

图 5：半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源: Wind, 天风证券研究所



资料来源: Wind, 天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为: 永太科技、和林微纳、中颖电子、芯源微、长川科技、南大光电、乐鑫科技、万业企业、景嘉微、北方华创。

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为: 睿能科技、博通集成、上海贝岭、恒玄科技、阿石创、盛剑环境、同有科技、正帆科技、真烦科技、睿创微纳。

表 2: 本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅
永太科技	23.6%	睿能科技	-4.4%
和林微纳	20.3%	博通集成	-4.6%
中颖电子	20.3%	上海贝岭	-5.1%
芯源微	16.2%	恒玄科技	-5.9%
长川科技	15.0%	阿石创	-6.1%
南大光电	14.7%	盛剑环境	-6.7%
乐鑫科技	14.5%	同有科技	-6.9%
万业企业	12.9%	正帆科技	-7.4%
景嘉微	12.6%	振芯科技	-9.6%
北方华创	12.4%	睿创微纳	-20.0%

资料来源: Wind, 天风证券研究所

## 4. 本周重点公司公告

### 【沪硅产业 688126.SH】

公司于 2021 年 9 月 11 日公告《**股东集中竞价减持股份计划公告**》。公告显示, 嘉定开发集团基于自身资金需求, 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内, 通过集中竞价方式合计减持不超过 12,400,000 股公司股份, 占公司总股本的比例不超过 0.5%, 具体减持价格将根据市场价格确定。

### 【正帆科技 688596.SH】

公司于 2021 年 9 月 10 日公告《**持股 5%以上股东减持股份计划公告**》。公告显示, (1) 因股东资金需求, 嘉赢友财及其一致行动人友财中磁拟通过集中竞价和大宗交易方式减持股份数量不超过 15,390,000 股, 即不超过公司股份总数的 6%。其中: 通过集中竞价方式减持的, 将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行, 减持期间为 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 4 月 12 日 (窗口期不减持)。(2) 因股东资金需求, 同系恒奇及其一致行动人同系嵩阳、同系九州拟通过集中竞价和大宗交易方式减持数量不超过 13,033,255 股, 即不超过公司股份总数的 5.08%。其中: 通过集中竞价方式减持的, 将于本减持计划披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行, 减持期间为 2021 年 10 月 13 日至 2022 年 4 月 12 日 (窗口期不减持)。

### 【晶瑞电材 300655.SZ】

公司于 2021 年 9 月 9 日公告《关于控股股东及部分监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》。公告显示，持有公司股份 63,267,725 股（占公司总股本比例为 18.57%）的公司控股股东新银国际有限公司（以下简称“新银国际”）计划通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持本公司股份，减持数量合计不超过 6,300,000 股（占公司总股本比例为 1.8494%）；持有公司股份 2,558,880 股（占公司总股本比例为 0.75%）的公司监事会主席常磊先生计划通过集中竞价方式减持本公司股份，减持期间自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 639,000 股（占公司总股本比例为 0.1876%）；持有公司股份 1,428,224 股（占公司总股本比例为 0.42%）的公司总经理薛利新先生计划通过集中竞价方式减持本公司股份，减持期间自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 350,000 股（占公司总股本比例为 0.1027%）；持有公司股份 497,893 股（占公司总股本比例为 0.15%）的公司副总经理胡建康先生计划通过集中竞价方式减持本公司股份，减持期间自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 124,000 股（占公司总股本比例为 0.0364%）；持有公司股份 141,204 股（占公司总股本比例为 0.04%）的公司副总经理常延武先生计划通过集中竞价方式减持本公司股份，减持期间自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过 35,000 股（占公司总股本比例为 0.0103%）。

#### 【雅克科技 002409.SZ】

公司于 2021 年 9 月 9 日公告《非公开发行股票发行情况暨上市公告书》。公告显示，本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。本次发行的发行数量最终为 13,074,175 股，符合发行人 2020 年第一次临时股东大会的批准要求。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 7 月 30 日），发行底价为 70.69 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。发行人、保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 91.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

#### 【三环集团 300408.SZ】

公司于 2021 年 9 月 8 日公告《关于潮州三环(集团)股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之上市保荐书》。公告显示，本次向特定对象发行募集资金总额不超过 390,000.00 万元（含发行费用），公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：大容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目，深圳三环研发基地建设项目。

#### 【精测电子 300567.SZ】

公司于 2021 年 9 月 7 日公告《关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成及承诺不减持公司股份的公告》。公告显示，截止本公告披露日，沈亚非先生本次减持计划已实施完成。沈亚非先生于 2021 年 9 月 6 日通过大宗交易减持公司股份 650,000 股，减持比例为公司股份总数的 0.23%。截止本公告披露日，沈亚非先生持有公司股份 2,109,478 股，占公司总股本的 0.76%。基于对公司未来发展信心以及对公司内在价值认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，沈亚非先生自愿承诺：自本承诺函出具之日起十二个月内，本人不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持所持公司的股份。

#### 【立昂微 605358.SH】

公司于 2021 年 9 月 7 日公告《首次公开发行限售股上市流通公告》。公告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1906号）核准，杭州立昂微电子股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）4,058 万股，并于 2020 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。

公司首次公开发行前总股本 36,000 万股，首次公开发行后总股本 40,058 万股。其中有限售条件流通股 36,000 万股，占公司总股本 89.87%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期为 12 个月，包括宁波利时信息科技有限公司等 169 名股东。上述股东持有本次上市流通的限售股共计 242,177,888 股，占公司总股本的 60.46%，将于 2021 年 9 月 13 日起上市流通。

#### 【瑞芯微 603893.SH】

公司于 2021 年 9 月 7 日公告《关于持股 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告》。公告显示，瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 6 日收到公司持股 5% 以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司发来的《瑞芯微电子股份有限公司股份减持计划实施进展告知函》，信息披露义务人自 2021 年 8 月 4 日至 2021 年 9 月 3 日期间，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 4,167,898 股，占公司总股本的 1%。

#### 【万业企业 600641.SH】

公司于 2021 年 9 月 7 日公告《股东权益变动超 1%暨集中竞价减持股份结果公告》。公告显示，本次减持股份计划实施前，三林万业（上海）企业集团有限公司持有上海万业企业股份有限公司无限售条件流通股 123,798,372 股，占公司目前总股本 12.92%。自本次减持计划时间区间起始日至本公告日，减持计划时间已届满。三林万业通过集中竞价交易方式累计减持 7,205,700 股，占公司目前总股本的 0.75%，减持计划实施完毕。

#### 【南大光电 300346.SZ】

公司于 2021 年 9 月 6 日公告《关于持股 5%以上的股东股份减持计划预披露的公告》。公告显示，持江苏南大光电材料股份有限公司 27,313,503 股（占公司已剔除回购专用账户股份后总股本的 6.54%）的股东南京大学资本运营有限公司计划以集中竞价交易方式减持本公司股份，计划减持股份数量不超过 4,178,500 股（占公司已剔除回购专用账户股份后总股本的 1%）。南大资本通过集中竞价交易方式进行减持，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后进行，减持计划开始日期为 2021 年 9 月 30 日，结束日期为 2021 年 12 月 31 日，任意连续 90 个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

## 5. 本周半导体新闻

### 5.1. IC 设计

**传中国台湾地区一线 IC 设计公司将在明年 Q1 提高芯片价格。**集微网消息，据业内消息人士透露，随着台积电的交货时间延长至 4-5 个月，中国台湾地区的一线 IC 设计公司已通知客户，从 2022 年第一季度开始，他们的芯片价格将进一步提升。digitimes 报道指出，消息人士称，除了一线 IC 设计公司外，许多其他台湾地区的 IC 设计公司也希望在未来三到六个月内上调芯片价格，以反映制造成本上升，可能会在明年生效。（集微网）

**核心业务利润下滑，澜起科技服务器 CPU 营收暴涨 698%。**首批登陆科创板的澜起科技，曾是国内首家市值超千亿美元的 IC 设计公司。今年上半年，众多半导体企业业绩飘红，澜起科技却同比下滑了 33.51%。根据澜起科技年中报告，该公司今年 1-6 月营收仅为 7.24 亿元，归母净利润约为 3.08 亿元，同比下滑 48.82%；扣非净利润仅为 1.78 亿元，同比下滑 65.93%。在上周的业绩说明会中，澜起科技董事长杨崇和认为主要是内存接口芯片行业的升级过渡，加之 2020 年上半年和下半年需求落差较大，导致目前行业整体仍处于去库存阶段。（集微网）

**台媒：LCD 面板制造商拒绝提价 驱动 IC 设计公司面临压力。**集微网消息，据业内消息人



士透露，LCD 驱动 IC 设计公司将上调报价，以反映芯片代工服务成本的持续上升，但由于面板价格自 2021 年第二季度末以来持续下跌，LCD 面板制造商不愿接受更高的价格。此前便有业内人士指出，尽管晶圆代工成本增加，但面板制造商预计将在第四季度缩减驱动 IC 订单，部分厂商已拒绝驱动 IC 合作伙伴提高报价的要求。该人士认为，驱动 IC 制造商的第四季度营收可能会受到这种情况的影响，因为他们将自我消化额外的成本。（集微网）

**联发科推芯片新品牌“迅鲲”，加码移动计算市场。**据介绍，MediaTek 迅鲲 1300T 芯片基于台积电 6nm 制程打造，采用 Arm Cortex-A78 和 Cortex-A55 组成的八核架构 CPU，以及 Arm Mali-G77 MC9 九核 GPU，不仅提供强劲性能，还针对热门游戏进行了高帧率适配，无论办公还是游戏竞技，都能提供出色的性能与续航表现。（半导体行业观察）

**云启智慧与紫光国微达成战略合作。**证券时报报道，近日，云启智慧科技有限公司（简称“云启智慧”）与紫光国芯微电子股份有限公司（简称“紫光国微”）在京签署战略合作协议。双方具体将在超级 SIM 卡应用领域，积极探索超卡与高考 U 选（高考志愿模拟填报平台）的合作模式，联合打造超级 SIM 一卡通等应用；同时，在智慧教育领域，双方将充分发挥各自优势，在智能门锁校园应用、智慧教育终端解决方案等方面开展合作，共同拓展智慧教育相关项目。（wind）

## 5.2. 设备/材料

**SEMI：Q2 全球半导体设备出货创新高 中国大陆地区登顶。**集微网消息，SEMI 当地时间周二（7 日）发布的报告显示，2021 年第二季度全球半导体设备出货量同比增长 48%，达到创纪录的 249 亿美元，较前一季度增长了 5%。分地区来看，中国大陆地区设备出货量再度超过韩国，较第一季度环比上升 38%、较去年同期同比上升 79%至 82.2 亿美元，韩国出货量 66.2 亿美元，中国台湾地区排名第三，日本、北美地区分列第四、第五。（集微网）

**华兴源创：SoC 类测试机已于 2021 上半年完成了客户端的批量装机。**集微网消息，9 月 10 日，华兴源创在最新披露的投资者关系活动记录表中称，公司半导体检测业务存在非标设备和标准设备两大类。目前公司非标半导体测试设备的发展战略主要瞄准大客户的大订单，为全球标杆大客户高性价比的测试解决方案；标准半导体设备的布局首先定位为 SOC 类测试机和射频专用测试机两个国内基本空白、急需国产替代的细分赛道，其次瞄准全球畅销机型，实施对标和兼容战略。（集微网）

**神工股份：已获得国内刻蚀机厂家小批量订单 8 英寸硅电极已得到 IC 厂家批量订单。**《科创板日报》8 日讯，科创板神工股份在互动平台上表示，公司硅零部件产品的主要客户有两大类：第一类客户是国内的刻蚀机厂家；第二类客户是国内的 IC 终端生产厂家。公司和国内知名刻蚀机厂家展开合作，已获得小批量订单。IC 厂家客户方面，经过 2020 年市场的开拓，公司 8 英寸硅电极已经得到了批量订单，2021 年重点推进 12 英寸客户的认证工作。（wind）

**中微公司：公司 MOCVD 设备签约进展正常进行中。**集微网消息，9 月 10 日，中微公司在与投资者互动时表示，公司 MOCVD 设备签约进展正常进行中。公开资料显示，今年上半年，中微公司营收达 13 亿元，同比增长 36.82%。其中 MOCVD 设备收入为 2.19 亿元，较去年同期下降约 10.08%，但 MOCVD 设备的毛利率达到 30.77%，较去年同期有大幅度提升。上半年新签订单金额达 18.89 亿元，同比增长超过 70%。另外，中微公司还表示，南昌基地和临港基地建设进展按照公司既定计划正常进行中。（集微网）

## 5.3. 代工/封测

**联电：晶圆代工产能供不应求 已在谈明年产能。**集微网消息，晶圆代工大厂联电受惠晶圆代工产能供不应求与涨价效应，近日股价频创新高，总经理简山杰表示，目前仍是供不应求，今年产能已销售一空，现在谈的是明年产能，客户倾向谈长期合作，对于涨价与股价问题则不评论。（集微网）

**英特尔 CEO：计划十年内斥资 950 亿美元在欧洲建八家芯片厂。**9 月 8 日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，芯片巨头英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格（Pat Gelsinger）表示，该公司计划斥资 950 亿美元在欧洲新建八家芯片厂，以应对全球芯片供应紧张之际各国竞相增加产能的局面。英特尔正考虑在欧洲某地新建两家芯片工厂，并可能进一步扩大规模，这将使未来大约十年的总投资达到相当于 950 亿美元的水平。（集微网）

**三星将在德州扩建芯片工厂，投资 170 亿美元。**9 月 9 日消息，据国外媒体报道，消息人士称，特斯拉主要供应商三星电子已选择在德克萨斯州泰勒市投资 170 亿美元建设一家芯片工厂。今年年初，三星电子宣布计划斥资 170 亿美元在美国建设一家芯片制造厂。（电子工程专辑）

**斥资 572 亿元，中芯国际临港再添一座 12 吋晶圆厂。**日前，中芯国际宣布已与上海自贸试验区临港新片区管委会签署了合作框架协议。根据合作协议，协议双方有意在临港自由贸易区共同成立合资公司，合资公司将规划建设产能为 10 万片/月的 12 吋晶圆代工生产线项目，聚焦于提供 28nm 及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。（wind）

**接下大马封测转单 日月光等安装新引线键合机。**集微网消息，近期，东南亚疫情反扑使得许多 IDM 在当地的封测厂产能受到严重影响。业内人士称，包括日月光、超丰电子、菱生精密、华泰电子在内的中国台湾 OAST 从 8 月起已开始安装额外的引线键合机，以应对来自马来西亚的转单。（集微网）

**长电科技：公司近日宣布正式推出 XDFOI™全系列极高密度扇外型封装解决方案。**长电科技（600584.SH）9 月 8 日在投资者互动平台表示，公司近日宣布正式推出 XDFOI™全系列极高密度扇外型封装解决方案，能够有效提高芯片内 IO 密度和算力密度的异构集成被视为先进封测技术发展的新机遇。该封装解决方案是新型无硅通孔晶圆级极高密度封装技术，相较于 2.5D 硅通孔（TSV）封装技术，具备更高性能、更高可靠性以及更低成本等特性。该解决方案在线宽或线距可达到 2um 的同时，可实现多层布线层，另外，采用了极窄节距凸块互联技术，封装尺寸大，可集成多颗芯片、高带宽内存和无源器件。目前已完成超高密度布线，即将开始客户样品流程，预计明年下半年量产。重点应用领域为：高性能运算应用如 FPGA、CPU/GPU、AI、5G、自动驾驶、智能医疗等。（wind）

#### 5.4. EDA/IP/其他

**2020 年成都集成电路项目拟支持名单公示，华大半导体、华大九天等入选。**集微网消息，9 月 9 日，成都市经济和信息化局公示了拟支持 2020 年成都市集成电路项目名单，包含 36 家企业及 1 所高校的共 49 个项目。购买 IP 核、EDA 方面，华大半导体（成都）有限公司、成都频尚微电子有限公司、成都市易冲半导体有限公司、成都启英泰伦科技有限公司、成都锐成芯微科技股份有限公司、成都二零嘉微电子有限公司、成都英思嘉半导体技术有限公司、成都振芯科技股份有限公司、四川和芯微电子股份有限公司、成都华大九天科技有限公司、成都奥卡思微电科技有限公司、成都芯源系统有限公司等入选。（集微网）

**国内 EDA 第一股诞生，华大九天科创板上市获批。**9 月 2 日，创业板上市委员会 2021 年第 54 次审议会议公告，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称华大九天）首发获通过。中信证券为其保荐机构，拟募资 25.51 亿元。招股书显示，华大九天此次拟于深交所创业板上市，计划公开发行业股票数量 1.09 亿股，占发行后公司总股本的比例为 20%。（wind）

## 6. 风险提示:

疫情继续恶化、贸易战影响、需求不及预期

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中南路 99	上海市浦东新区兰花路 333	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	号保利广场 A 座 37 楼	号 333 世纪大厦 20 楼	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430071	邮编：201204	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-68815388	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-68812910	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com